



股票代號
6525



捷敏股份有限公司
GEM Services, Inc.

法人說明會
2021/04/09



免責聲明

本次法說會所提供之簡報內容包括對於未來狀況之預測與評估之陳述，乃基於公司目前可得資料之概略說明，其涉及風險及不確定性，並可能發生實際結果與預期狀況有重大差異的情形，提醒各位不要依賴這些資訊，另除非法律要求本公司將不負責更新或公告這些預測的結果。

簡報內容

- 公司概况
- 營運概況
- 財務概況
- 未來展望
- Q&A

公司概況

創立

- 成立於1998年

產能

- 54億顆年封測產能

特別技術

- Multi-chip Module (多晶粒模組)
- J-lead Wide Body (內彎腳型封裝)
- Leadless (底部貼焊型)
- Bond-wireless(非鉚線結構):
Flip chip, Cu Clipper

終端應用

- 電腦, 手機, 手持電子產品
- LCD / 電漿顯示器
- 家電產品

員工

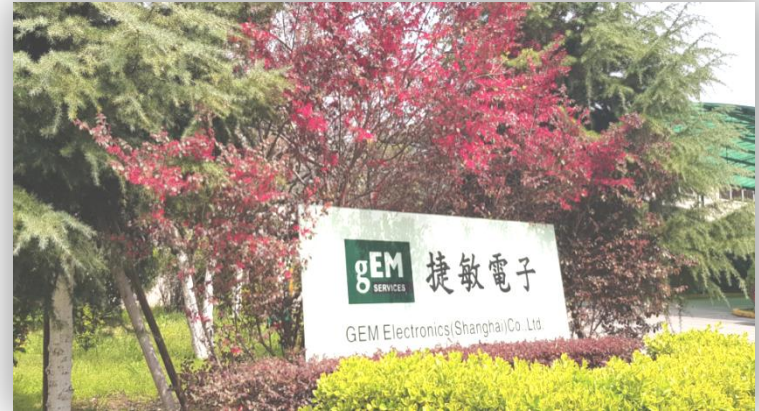
- 員工人數: 1,750+ (技術人員: 500+)

營運據點

- 總部: 台灣新北市中和區

主要股東

- 聯鈞光電股份有限公司 (持股51%)



- 工業電子系統
- 風力/太陽能電力系統
- 電動車/車載電子

- 上海廠: 中國上海市嘉定區
- 合肥廠: 中國安徽省合肥市



- 土地面積: 19,000 平方公尺 (租賃)
- 建築佔地面積: 15,400 平方公尺
- 樓地板面積: 17,836 平方公尺



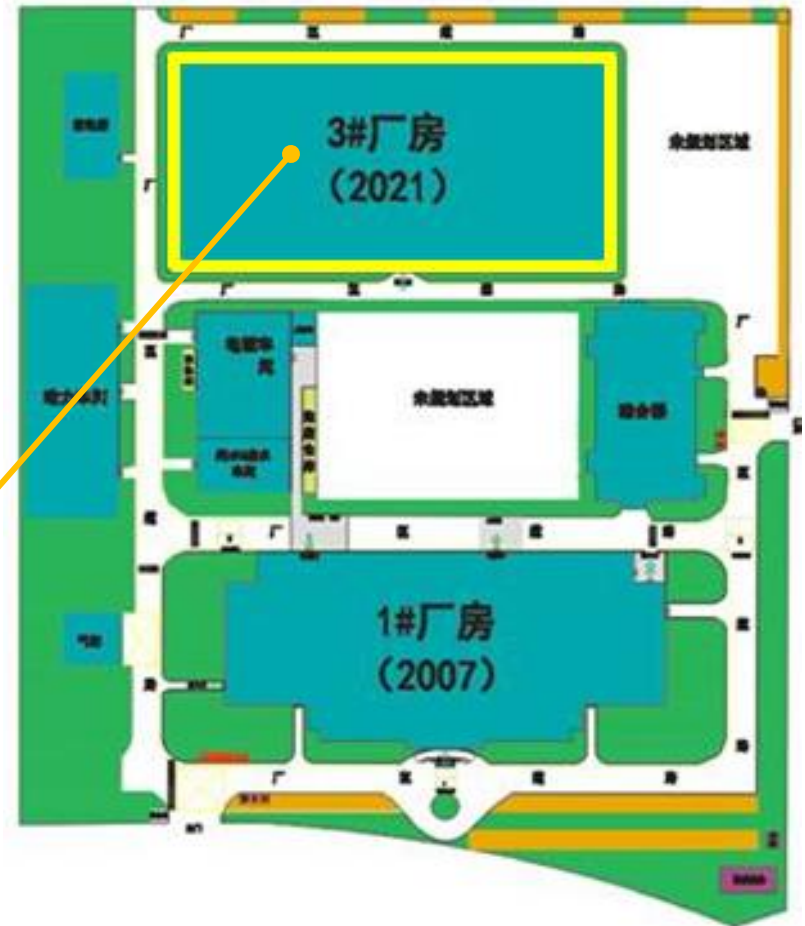
Bd#1

- 土地面積: 69,812平方公尺 (自有)
 建築佔地面積: 17,920平方公尺
 樓地板面積: 28,588平方公尺
- 合肥新廠房(Bd#3)增建中
 建築佔地面積: +10,368平方公尺
 樓地板面積: +39,096平方公尺



Bd#3

厂区布局图



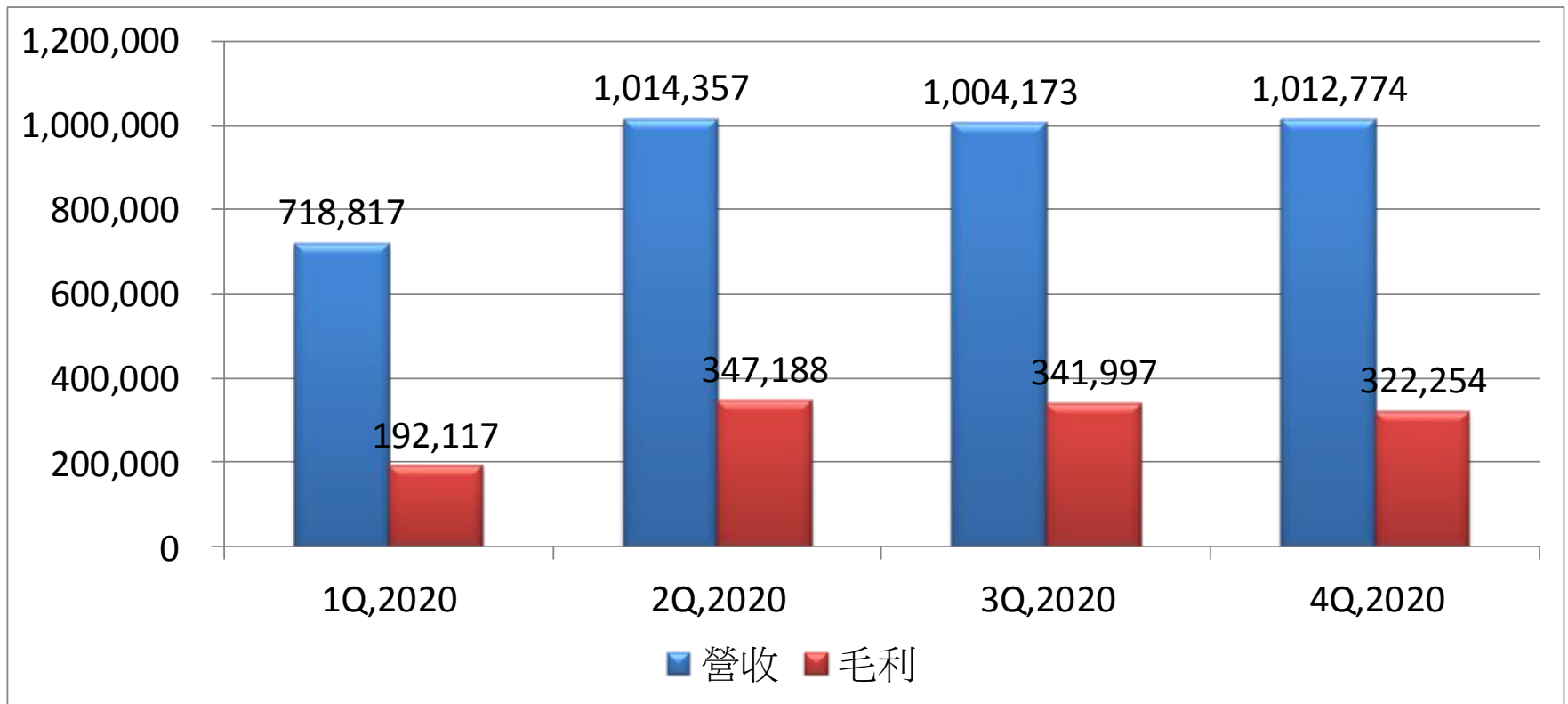
- 提供 高低壓功率金氧半場效電晶體(Power MOSFET)、絕緣柵雙級型電晶體(IGBT)、二極體(Diode)及電源轉換或電源管理 IC (Power Management ICs)、功率模組等之封裝與測試服務
- 主要應用於 通訊、電腦/筆電主機板及周邊產品、家電消費性電子產品, 以及任何需要電力系統供其運轉之車用電子及工業用設備機具應用等



營運概況

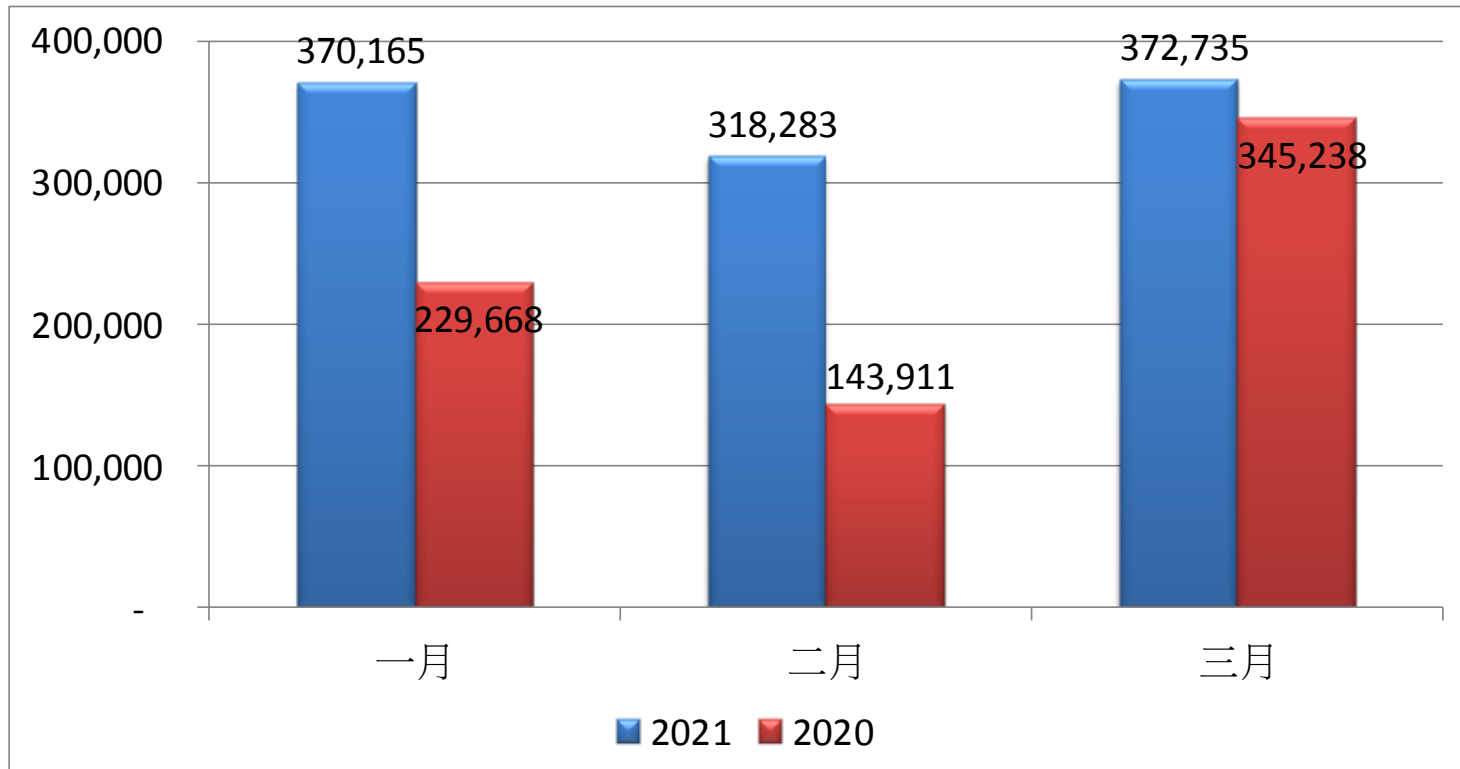
2020年各季合併營收與毛利

新台幣：仟元



2021年各月份合併營收

新台幣：仟元



合併損益表

單位：新台幣仟元

	2019年	2020年				
	合計	第1季	第2季	第3季	第4季	合計
營業收入	3,463,053	718,817	1,014,357	1,004,173	1,012,774	3,750,121
營業毛利	1,084,495	192,117	347,188	341,997	322,254	1,203,556
毛利率	31.30%	26.73%	34.23%	34.06%	31.82%	32.09%
營業費用	289,549	62,520	78,523	73,083	69,858	283,984
營業淨利	794,946	129,597	268,665	268,914	252,396	919,572
營業淨利率	23.00%	18.03%	26.49%	26.78%	24.92%	24.52%
營業外損益	44,015	27,733	(16,427)	(46,007)	(24,954)	(59,655)
稅前淨利	838,961	157,330	252,238	222,907	227,442	859,917
所得稅費用	173,975	27,972	53,732	46,717	46,835	175,256
本期淨利	664,986	129,358	198,506	176,190	180,607	684,661
EPS	5.15	1.00	1.54	1.37	1.40	5.31

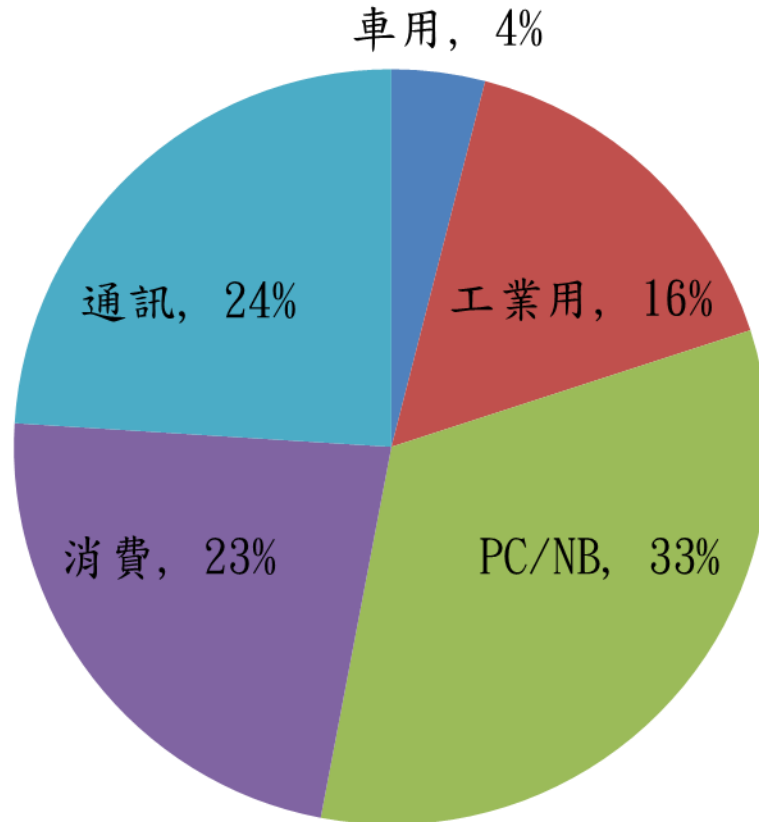
合併資產負債表

	單位：新台幣仟元				
	2019年	2020年			
	第4季	第1季	第2季	第3季	第4季
現金及約當現金	2,011,897	2,030,261	2,177,240	1,732,601	1,877,074
應收款項	633,131	626,283	770,009	807,480	782,786
存貨	96,106	122,775	121,558	154,845	117,633
流動資產合計	3,011,890	3,045,927	3,359,653	2,998,734	3,090,109
不動產廠房設備	1,353,778	1,316,206	1,334,902	1,363,170	1,544,622
非流動資產合計	1,697,881	1,667,843	1,702,111	1,813,149	2,061,161
資產總計	4,709,771	4,713,770	5,061,764	4,811,883	5,151,270
應付帳款	501,453	448,545	552,085	584,125	583,794
流動負債合計	1,058,893	1,403,955	1,594,541	1,134,590	1,291,982
非流動負債合計	38,420	28,962	21,192	16,944	9,932
負債總計	1,097,313	1,432,917	1,615,733	1,151,534	1,301,914
普通股股本	1,290,474	1,290,474	1,290,474	1,290,474	1,290,474
資本公積	624,536	624,536	624,536	624,536	624,536
保留盈餘	1,907,007	1,584,699	1,783,205	1,959,395	2,140,002
其他權益	(209,559)	(218,856)	(252,184)	(214,056)	(205,656)
權益總計	3,612,458	3,280,853	3,446,031	3,660,349	3,849,356
負債比率	23.30%	30.40%	31.92%	23.93%	25.27%
流動比率	284.44%	216.95%	210.70%	264.30%	239.18%
本公司每股淨值(元)	27.99	25.42	26.70	28.36	29.83

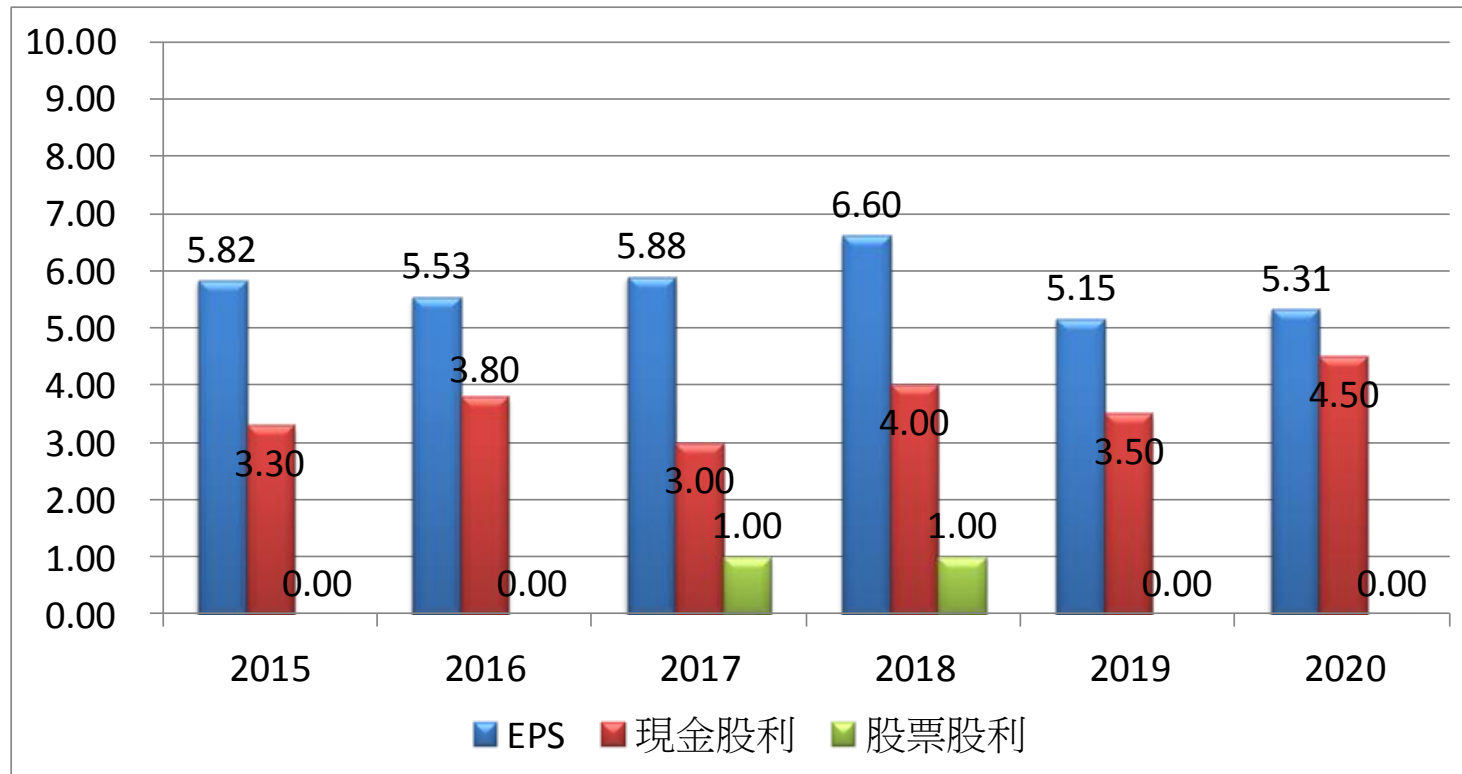
合併現金流量表

	單位：新台幣仟元				
	2019年	2020年			
	合計	第1季	前2季	前3季	全年
營業活動淨現金流入(出)	1,036,258	120,042	421,653	572,839	996,853
投資活動淨現金流入(出)	(322,796)	(99,737)	(198,861)	(334,247)	(568,303)
籌資活動淨現金流入(出)	(495,144)	(11,139)	(17,737)	(476,082)	(483,838)
匯率變動影響	(70,028)	9,198	(39,712)	(41,806)	(79,535)
現金及約當現金淨增(減)	148,290	18,364	165,343	(279,296)	(134,823)
期初現金及約當現金餘額	1,863,607	2,011,897	2,011,897	2,011,897	2,011,897
期末現金及約當現金餘額	2,011,897	2,030,261	2,177,240	1,732,601	1,877,074

2020年營收應用別



單位：新台幣元



- 擴增合肥廠產能，目前專注高電壓產品開發與生產為主。新廠建設完成後，產品業務發展方向將做計劃性之擴充。
- 持續高附加價值，以及第三代半導體相關產品之開發。
- 5G、工業用及車用產品市場仍是未來發展的重點。

Q&A

謝謝

